上海艾为电子技术股份有限公司董事会

关于本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条、《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的说明

上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买钰泰半导体股份有限公司（以下简称“钰泰半导体”）100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条及《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条的规定，科创板上市公司实施发行股份购买资产的，拟购买资产应当符合科创板定位，所属行业应当与科创板上市公司处于同行业或者上下游，且与科创板上市公司主营业务具有协同效应，有利于促进主营业务整合升级和提高上市公司持续经营能力。

经审慎判断，本次交易的标的公司符合科创板定位，标的公司所属行业与上市公司属于同行业，与公司主营业务具有协同效应，有利于促进主营业务整合升级和提高公司持续经营能力。本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条及《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定，具体如下：

一、标的公司符合科创板定位，与上市公司处于同行业

上市公司与标的公司同属于集成电路设计行业。按照《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，上市公司与标的公司所处行业同属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”（代码：6520），为国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》规定的鼓励类产业。根据《战略性新兴产业分类（2018）》，上市公司与标的公司所处行业亦均为“新一代信息技术产业”。标的公司属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第五条中的“（一）新一代信息技术领域”之“集成电路”，符合科创板定位。上市公司与标的公司均采

用 Fabless 经营模式，主营业务均为芯片的研发、设计与销售，本次交易属于同行业产业整合。

二、标的公司与上市公司主营业务的协同效应

上市公司与标的公司同属于芯片设计企业，双方在产品、研发、客户、市场、供应链资源等方面均具有显著协同效应。本次交易整合后，双方可实现深度协同发展，增强上市公司的持续经营能力，并提升市场竞争力和行业影响力。

1、产品协同：丰富产品矩阵，构建一体化方案能力

上市公司已形成音频功放、触觉反馈、影像运动控制、智能传感器、射频前端和信号链等产品体系；标的公司聚焦通用电源管理芯片的研发、设计与销售，产品覆盖 DC/DC、LDO、电池管理芯片、多通道 PMIC 等核心品类，与上市公司现有产品重合度有限、互补性较高。通过本次交易，上市公司可快速形成覆盖数模混合、信号链和电源管理的完整产品组合，增强面向多元应用场景的系统级解决方案能力。

上市公司位于上海临港的车规级芯片测试中心是目前国内规模最大的车规实验测试中心，具备从样品摸底、工程验证到量产合规检测的全流程车规测试验证能力，搭载国内首家自研测试机台射频 AT5000 鸿鹄、数模 AT6000 朱雀，率先建成自动化机器人中试产线且完成调试，并已获得 CNAS 实验室认可、ISO9001 质量管理体系认证等资质。本次交易完成后，上市公司车规级芯片测试中心可为标的公司车规电源、负载开关、摄像头 PMIC 和背光驱动等产品提供全流程车规测试验证服务，缩短认证周期并降低测试成本，有助于提升双方车规产品组合的系统级验证与协同交付能力，进一步提升市场综合竞争力。

2、研发协同：研发资源融合，联合研发突破创新

标的公司坚持正向设计，积累了较为完整的自研底层电源 IP，在环路控制、驱动与保护等电路设计上形成了自身方法论。上市公司则在数模混合 SoC、音频算法、触觉反馈算法及信号链电路设计方面积累深厚。双方在晶圆工艺平台、封装测试、可靠性验证等环节的业务流程相近，在工艺选型、器件模型、版图实现与验证方法等环节具备经验共享基础，可复用的技术要素较多，双方研发团队合并后，可以大幅缩短新产品的开发周期、减少同类品类的重复开发，形成单一企业较难独立构建的技术组合。

3、销售协同：共享客户资源，协同拓展市场

上市公司客户以智能手机及泛消费领域品牌客户和头部 ODM 厂商为主，并已进入汽车品牌及全球科技企业供应链；标的公司终端客户数量众多，覆盖工业控制、安防监控、网络通信等泛工业领域，双方客户群体互补性较强。终端客户通常具备一揽子芯片采购需求，本次交易完成后，双方可实现客户资源与销售网络的双向共享与交叉推介，提升单客户价值与客户粘性，并联合拓展汽车电子、算力中心和储能等双方共同布局的市场。

4、供应链协同：整合采购体系，提升议价能力与供应保障

双方均采用 Fabless 模式，主要采购晶圆制造与封装测试服务，采购品类高度重合。本次交易完成后，双方通过整合采购体系、实施集中采购，可扩大采购规模、提升对上游供应商的议价能力，优化产能安排与交付保障，并降低单一供应商依赖风险，增强供应链韧性。标的公司已与境内外主要晶圆代工厂及封装测试企业建立了长期稳定的合作关系，将为上市公司供应链的全球化拓展提供强有力的补充和支持。

特此说明。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日